

セミオートIC挿抜機 **MIR-0201S**

リテストなど少量のIC挿抜に限定した手動段取り替え方式の廉価装置

☆ リテストICの挿抜に

☆ 試作ICの挿抜に

☆ パーインボードのメンテ評価に



- ICTレイ2枚・パーインボード1枚の双方向IC挿抜機
(トレーおよびボードの交換は手動)
- タッチパネルにより、品種登録、品種切替が可能
- 位置決めポケット、ICTレイ、パーインボードの段取り替えに
ワンタッチ機構を多用しスピーディな品種切替が可能
- 2ヘッドによる挿抜 2.5sec/IC(標準仕様)
- デバイスにストレスを与えない機構を各所に装備
(オプション)

※ 供給トレイ・収納トレイ・パーインボードのチェンジャー付フルオートタイプにも対応可能

※ NGソケット位置情報のタッチパネル・通信による登録も可能です。

※ 供給スティック、収納スティックにも対応可能です。 詳細は、ご相談ください。



仕様

項目	仕様
対象デバイス	TSOP I TSOP II QFP BGA CSP など
搬送方式	圧力センサ・ストロークダンパ付吸着ヘッドピックアップ×2ヘッド
デバイス方向チェンジャー	ICTレイ⇒BIボード挿抜時にデバイス向きを回転(90°・180°・270°)
サイクルタイム	4.0sec/IC (IC回転なし 2.5sec/IC)
供給収納トレイ	2枚 160×320×t5~10mm 以下
パーインボード	1枚 (サイズ形状は、打合せによる)
品種登録	30品種
品種切替	タッチパネル チェンジキット交換により 1min/品種 以下
JAM率	0.1%以下
外観寸法・重量	1300(W)×1275(D)×1470(H) 約250Kg
ユーティリティ	AC100V±10 50/60Hz 1.5KVA Air 0.5MPa 70L/min